



半導体製品の正規品との比較調査サービス

半導体製品の真贋判定のため、正規品との比較調査サービスを行います。

なぜ、正規品との比較調査が必要か

現在、世界的に半導体製品が不足しており、正規ルートから半導体製品(IC)を入手することが困難な場合、やむを得ず非正規ルートの流通在庫から調達することがあります。しかし流通在庫の半導体製品の一部には、正規品とは異なる偽物が混入している可能性があります。当社は、**半導体製品(IC)の真贋判定のため、正規品との比較調査を行います。**

半導体製品の正規品との比較調査方法

1. 外観観察

パッケージのマーキングや樹脂成型の痕跡について観察し、調査品と正規品に差異について調査します。

また、半導体製品調査品(図1)のマーキング修正(リマーク)の痕跡の有無についても調査します。

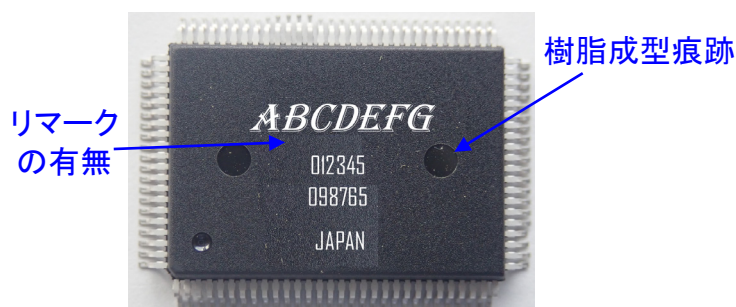


図1 半導体製品調査品例

2. 透過X線観察

透過X線像(図2)によりリードフレームの形状やワイヤーボンディング位置について観察し、調査品と正規品に差異があるか調査します。

リードフレーム形状 ワイヤーボンディング位置

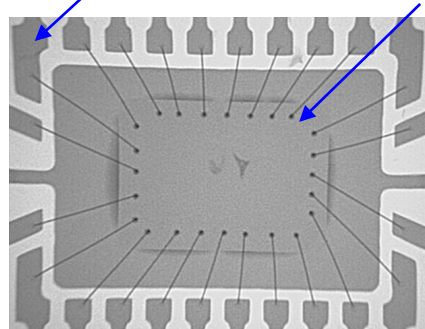


図2 透過X線像

3. 電気特性検査

GNDと各端子間の電圧電流特性(図3)を測定し、調査品と正規品に差異があるか調査します。

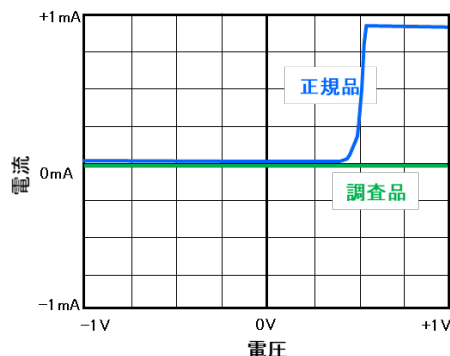


図3 電圧電流特性測定結果イメージ

4. 開封観察

パッケージ樹脂を溶解除去した後、ICチップのロゴや配線パターンを観察(図4)し、調査品と正規品に差異があるか調査します。

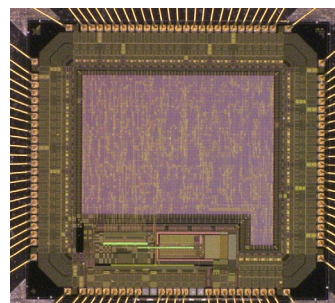


図4 ICチップ表面の光学顕微鏡像



JFE テクノリサーチ 株式会社

<https://www.jfe-tec.co.jp>

0120-643-777

Copyright ©2022 JFE Techno-Research Corporation. All Rights Reserved.
本資料の無断複製・転載・webサイトへのアップロード等はおやめ下さい。